

25.09.2017 - 08:01 Uhr

Anwendungsfälle für microQSFP mit industrieller Umsetzung in 2x50G und 1x50G Anwendungen weiter ausgeweitet

TE Connectivitys Steckverbinder microQSFP gewinnt rasant an Zugkraft im Markt

Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Wie TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen der Verbindungs- und Sensortechnologie, heute bekanntgibt, gewinnen die steckbaren Verbinder, Cages und Kabelsätze seiner microQSFP Lösung rasant an Traktion in der Branche, wie sich anhand von Design Wins bei Cloud-Serveranwendungen und den laufenden signifikanten Entwicklungsbestrebungen bei Switches für Rechenzentren und Wireless Networking-Equipment zeigt.

microQSFP ist die neue Generation von Input/Output (I/O)-Steckverbindern, die ein-, zwei- und vierkanalige steckbare Lösungen mit der gleichen Funktionsbreite wie QSFP28/56 und der Frontplatten-Dichte von SFP (einer einkanaligen Lösung) ermöglicht. Bedeutsam ist hier auch, dass der microQSFP Formfaktor in den Entwurf der IEEE P802.3cd Spezifikation eingeflossen ist, die den Industriestandard für elektrische 50 Gbit/s, 100 Gbit/s und 200 Gbit/s Schnittstellen auf Basis elektrischer 50 Gbit/s Kanälen schaffen will. Der jüngste Meilenstein für die Branche ist dabei die von der Arbeitsgruppe veröffentlichte Revision 2.5 der microQSFP Spezifikation für das Multi-Source-Agreement (MSA), welche die interoperable Methodik für Ein-, Zwei- und Vier-Kanal-Anwendungen definiert.

Der microQSFP Formfaktor eignet sich ideal für Switches für cloudbasierte und Unternehmensrechenzentren, Server-Netzwerkkarten (NICs), PCI Switching, Speicher und Wireless-Anwendungen. microQSFP unterstützt kupferbasierte und optische Verbindungen, bietet hohe Dichte, liefert hervorragende Signalintegrität (mit geplant bis zu 100 Gbit/s per Lane), und verfügt über das branchenweit führende Wärmemanagementkapazität (bis zu 7 Watt). microQSFP unterstützt ein breites Spektrum von Anwendungen und bietet dem Markt einen kostengünstigen Formfaktor mit stark wettbewerbsfähiger Thermoeffizienz.

Brad Booth, Principal Network Architect im Azure Infrastructure Team von Microsoft, erklärt: "Die microQSFP Technologie verfügt über überzeugende Features und Vorteile und entspricht den Bedürfnissen, die das Next-Generation-Rechenzentrum mit sich bringt. microQSFP bietet für die neue Generation von Switch ASICs Unterstützung für die höhere Verbindungsdichte an der Frontplatte des traditionellen 1RU Pizza Box-Switch. Die neuen Architekturen müssen simultan mit den Dichteanforderungen an Switches und gleichzeitig der thermischen und elektrischen Leistung bei sowohl Switches wie auch Server-Equipment umgehen können. Die Fähigkeit von microQSFP, elektrische Einfach-, Doppel-, Quad-Kanal-Schnittstellen anzusprechen, ist gut auf diese Bedürfnisse abgestimmt".

"Arista richtet sich immer stark auf die Kundenbedürfnisse aus, und der microQSFP Formfaktor bringt die passenden Leistungsklassen für unsere Kunden mit, die ihren Anforderungen in Bezug auf elektrische Kanäle, Wärmemanagement und Portleistungsdichte entsprechen", so Christophe Metivier, Vice President Manufacturing and Optics bei Arista. "Die Industrie bereitet sich auf den Übergang von elektrischen Kanälen mit 25G auf elektrische Kanäle mit 50G vor, und microQSFP kann als ideale Plattform beide Datenraten unterstützen und gleichzeitig die Flexibilität von einem, zwei oder vier Kanälen pro Modul gewährleisten".

microQSFP ist aufgrund seiner thermischen Leistung und niedrigen Kosten der ideale Formfaktor für alle Optics-Varianten; von Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Rechenzentrums bis hin zu Anbindungen mit großer Reichweite, die Rechenzentren und Netzwerke mit breiterer Abdeckung verbinden. "Der microQSFP Formfaktor ist eine gute Plattform für AOIs Glasfaser mit exzellenter Signalintegrität bei sowohl SMT- als auch Stapel-Steckverbindern, und gleichzeitig eine einfach zu implementierende thermische Lösung", sagt AOIs Chan Chih (David) Chen, AVP Sales & Marketing. "Unsere Kunden wollen höhere Dichte und die Flexibilität, Glasfaser auf Server NIC und Switching-Equipment auszudehnen. microQSFP kombiniert genau die richtigen Funktionen, um dies für uns umsetzbar zu machen".

Lucas Benson, microQSFP Produktmanager bei TE Connectivity, stellt fest: "microQSFP ist, da sich die Industrie in Richtung 25, 50 und 100 Gbit/s und noch weiter bewegt, eine hervorragende Lösung für eine ganze Reihe von Netzwerkgeräten. Die Branche richtet sich insgesamt auf höhere Geschwindigkeiten und vor allem High-Density 100G (2x50G) ein, und wir erwarten, dass das Momentum für microQSFP weiterhin anhält und sogar noch weiter an Dynamik gewinnt".

Hochvolumige, produktionsgefertigte Ware kann in der Varianten SMT (1xN Konfigurationen) und pressgepasste Stapel-Steckverbindung (2xN Konfigurationen) direkt von TE und seinen Distributoren bezogen werden. Direct Attach-Kupferkabel microQSFP Stecker sind ebenfalls direkt über TE sowohl als freier Stecker als auch als Breakout-Konfiguration verfügbar, mit Übergangskabeln für die Formfaktoren QSFP und SFP. Mehr zu microQSFP und zum Produktportfolio finden Sie hier (<http://www.te.com/usa-en/products/connectors/pluggable-connectors-cages/microqsfp.html?source=header-match&tab=pgp-story>).

INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITY

TE Connectivity (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte in verschiedenen Bereichen: Transport, industrielle Anwendungen,

Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause. TE bietet eine unübertroffene Bandbreite an Verbindungs- und Sensorlösungen, die sich unter extrem anspruchsvollen Bedingungen bewährt haben. So helfen wir, unsere Welt zuverlässiger, sauberer, intelligenter und vernetzter zu machen. Mit 75.000 Mitarbeitern, darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus rund 150 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. www.TE.com.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken der Konzernfamilie TE Connectivity Ltd.

Bei anderen hier angeführten Logos, Produkt- und/oder Firmennamen kann es sich um Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/560111/TE_Connectivity_microQFSP_Connector.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

Kontakt:

Pressekontakt: Megan Vere
TE Connectivity
717-986-7227
megan.veres@te.com

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100060843/100807197> abgerufen werden.